

颜金勇：超越“开放、互联和高效枢纽”定位 我国须提升领导优势抓住半导体新机遇

副总理兼贸工部长颜金勇在耗资5亿美元打造的美国半导体设备制造商应用材料公司淡滨尼新园区开幕仪式上说，新加坡须提升价值主张，超越“开放、互联和高效枢纽”的定位，为企业的发展提供一个值得信赖、勇于创新且富有韧性的基地，特别是在半导体等高速增长的领域。

萧梓卉 报道
siowzh@sph.com.sg

半导体行业正在快速发展，竞争也在不断加剧。新加坡不能原地踏步，须在能发挥重大作用、且能力难以复制的领域加强领导地位，以保持竞争力。

副总理兼贸工部长颜金勇星期三（6月10日）在耗资5亿美元（约6.43亿新元）打造的美国半导体设备制造商应用材料公司（Applied Materials，简称应材）淡滨尼新园区开幕仪式上，做出以上表述。

他说，新加坡须提升价值主张，超越“开放、互联和高效枢纽”的定位，为企业的发展提供一个值得信赖、勇于创新且富有韧性的基地，特别是在半导体等高速增长的领域。

这是因为，企业要抓住半导体新机遇，不能只靠扩大规模，还需可靠的基地展开关键业务、吸引优质人才、融入完善的生态系统，让它们有信心地进行长期投资。

过去50年，新加坡已在晶圆



为应对晶片需求增长，美国半导体设备制造商应用材料公司扩大在新加坡的生产能力，位于淡滨尼的新园区正式启用，产能将增加超过一倍。副总理兼贸工部长颜金勇（前排左二）和应用材料首席执行官迪克森（右一）一同出席新园区开幕仪式。（陈斌勤摄）

制造、半导体设备、先进封装、集成电路设计、特种化学品、精密工程及研发创新等领域，构建了强大的生态系统。

接下来，新加坡将吸引并巩固新的投资和能力，以深化生态系统，强化新加坡在全球供应链中的作用，并为国人创造优质就

业机会。此外，新加坡也会协助现有业务转型升级，并且让投资在生态系统中更深地扎根。

颜金勇说：“像应材这样的全球领先企业深化在新加坡的业务，不仅为本地供应商创造机会，也增强我们先进的制造业基础，帮助新加坡企业融入全球价

值链。”

扩大产能应对晶片需求增长

在新加坡发展已有35年的应材斥资6亿元，在淡滨尼建设的新园区可进一步拓展本地制造与研发业务。新设施占地约70万平方英尺，目前已投入量产，先进洁

净无尘室（clean room）产能扩大超过一倍。

未来几年，公司预计在本地产新增约1000个就业岗位，包括制造、研发、总部运作和服务等领域，以支持半导体产业增长和技术商业化。目前，公司在本地有超过2000名员工。

公司也计划在2027年前，将实习计划规模扩大到每年100个名额。

应材首席执行官迪克森（Gary Dickerson）指出，人工智能（AI）正改变各行各业，为先进半导体带来前所未有的需求。他说，公司扩大新加坡产能，以增强交付半导体制造设备的能力，协助晶片制造商更快地将下一代晶片推向市场。

迪克森也提到，公司的半导体业务增长超过30%，随着代理式人工智能（Agentic AI）兴起，计算需求将持续增长。他说：“我们不想成为客户在未来发展壮大的瓶颈，所以进行了投资。”

他补充说，只要客户能够提前八个季度提供需求量预测，公司就有信心能满足这些需求。

携手两家学府 培养半导体人才

应材也宣布与新加坡国立大学和新加坡理工大学合作，加强半导体研发和人才培养。

国大将通过与应材共同设立的实验室，利用AI加速半导体工艺开发。同时，国大在今年8月推出新的专业方向，培养具备AI和半导体技能的人才。

新工大则与应材携手，设立“应用材料教授席”（The Applied Materials Professorship）和应用材料奖学金。其中，奖学金将资助来自经济困难家庭的工程专业本科生，帮助培养一批具半导体制造、AI、先进自动化领域技能的工程师、研究人员和专才。